

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260121

投资者关系 活动类别	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div>
参与单位名称 及人员姓名	嘉实基金：王贵重、何鸣晓、彭民、孟丽婷、赵钰、陈俊杰、刘晔、安昊、吴振坤、吴悠、常蓁、陈涛、归凯、孟夏、李涛、黄福大、左勇，华源证券：白宇，共 18 名投资者及证券人员
时间	2026 年 1 月 21 日上午 9:00~10:30
地点	公司 9 楼会议室
上市公司接待 人员姓名	2026 年 1 月 21 日上午 9:00~10:30：总经理朱顺全先生、董事会秘书杨平彩女士、投资者关系总监熊亚威先生
投资者 关系活动 主要内容 介绍	<div><div>公司介绍：</div><div>公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，主营业务横跨两大板块一半导体业务板块、打印复印通用耗材业务板块。现阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电路用 CMP 抛光垫国内供应龙头，占据 OLED 新型显示材料 YPI、PSPI 国内供应领先地位，深度布局半导体 KrF/ArF 晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务。此外，在打印复印通用耗材业务板块，公司全产业链布局，上游提供彩色聚合碳粉、显影辊等打印复印耗材核心原材料，下游销售硒鼓、墨盒两大终端耗材产品，实现产业上下游的联动，支持公司在该行业内的竞争优势地位。</div></div> <div><div>问 1：公司 CMP 抛光垫业务作为国产龙头，核心竞争优势主要体现在哪些方面？</div><div>答：公司是国内唯一一家全面掌握 CMP 抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的供应商，核心竞争优势主要体现在四个方面：一是产品型号齐全，覆盖硬垫、软垫，可匹配不同客户的多样化需求，产品型号覆盖率处于国内领先水平；二是核心原材料自主化，已全面实现 CMP 抛光硬垫核心原材料的自主制备，保障产品品质可控及供应链安全，同时带来一定成本优势；三是技术迭代速度快，应用节点覆盖下游客户端所有制程，能够同步匹配下游</div></div>

	<p>客户的技术升级需求；四是具备系统化服务能力，搭配 CMP 抛光液、清洗液形成一站式 CMP 材料解决方案，技术服务响应速度快，客户合作黏性强，国产供应龙头地位稳固。</p> <p>问 2：公司半导体显示材料业务中，YPI、PSPI 产品表现优异，新产品验证进展是否符合预期？</p> <p>答：公司在 OLED 新型显示材料领域占据国内领先地位，YPI、PSPI 产品的市场地位持续稳固，客户主要覆盖国内主流 OLED 面板厂，建立了长期稳定的合作关系，复购属性强，为公司带来持续稳定的现金流。此外，TFE-INK 产品已在客户端规模销售，市场突破成效显著。产能方面，仙桃产业园年产 1000 吨 PSPI 产线已投产并持续批量供应，年产 800 吨 YPI 二期项目作为新增产能补充，可充分满足现有及潜在客户订单需求。新产品方面，无氟光敏聚酰亚胺（PFAS Free PSPI）、黑色像素定义层材料（BPDFL）、薄膜封装低介电材料（Low Dk INK）等正按计划推进客户验证工作，目前验证进展符合预期；同时，PI 取向液的产品开发持续推进，在客户端的验证、导入已全面展开，多款新一代 OLED 显示材料的创新研发及送样验证，目标填补相关领域空白。</p> <p>问 3：公司研发投入持续增加，请问研发投入具体情况及 2026 年研发重点是什么？</p> <p>答：研发投入的增加主要系 CMP 抛光液、高端晶圆光刻胶业务对产品型号系统布局的要求较高，以及半导体先进封装材料等新业务的投入。2026 年，公司将持续保持高水平的研发投入规模，优化研发资源配置，研发重点主要聚焦于三大方向：一是深化 CMP 相关材料研发，推进 CMP 抛光液多系列产品完善，加快铜及阻挡层抛光液、搭载氧化铈研磨粒子的抛光液等产品的验证及放量；二是推进高端晶圆光刻胶、半导体先进封装材料的产业化进程，加快相关产品的客户验证及市场开拓；三是持续推进半导体显示材料新产品研发，同步跟进下游客户技术升级需求，巩固显示材料领域的领先优势。</p> <p>问 4：目前宏观经济及行业形势变动，对公司带来的机遇是什么？</p> <p>答：当前宏观经济及行业形势变动下，各类发展机遇集中显现，为公司未来快速增长提供了坚实支撑、创造了广阔空间，核心机遇主要体现在四个方面：一是 AI 产业快速发展持续驱动下游半导体芯片及高端显示面板需求扩容，直接带动上游半导体材料、显示材料市场规模稳步增长，公司核心产品精准契合下游增长需求，将持续受益于行业需求红利，实现销量与收入的双重提升；二是全球半导体产业链供应链重构背景下，客户对供应链稳定性、安全性的需求大幅提升，公司核心原材料自主化优势显著，可充分保障产品供应的连续性与可控性，能够更好地契合客户核心诉求，进一步扩大客户合作范围、提升合作深度；三是大硅片、先进封装等新兴领域快速崛起，持续打开半导体材料的增量市场空间，公司提前布局相关配套材料研发与生产，可率先抢占市场先机，培育新的增长动能，为业绩快速增长注入新活力；四是半导体及新型 OLED 显示行业整体保持增长态势，叠加公司核心产品市场渗透率持续提升，核心业务放量节奏加快，同时公司前期孵化的新业务逐步</p>
--	--

	<p>进入收获期，各类业务协同发力，将持续推动公司整体规模快速扩张、盈利能力稳步提升，为未来高速增长奠定坚实基础。</p> <p>问 5：公司 CMP 抛光垫、半导体显示材料放量速度较快，当前产能是否存在瓶颈，后续产能布局规划如何？</p> <p>答：公司前瞻性进行产能布局，目前整体产能能够满足现有订单需求，未出现明显产能瓶颈。具体来看，CMP 抛光垫方面，武汉本部抛光硬垫产线产能至 2026 年一季度预计提升至月产 5 万片左右（即年产约 60 万片），为未来进一步放量销售做好了产能储备，后续将根据市场需求及订单情况，适时优化产能布局。半导体显示材料方面，仙桃产业园年产 1000 吨 PSPI 产线已投产并持续批量供应，产能布局及生产体系能力持续提升；年产 800 吨 YPI 二期项目作为新增产能补充，可充分满足现有及潜在客户订单需求，以缓解武汉本部 YPI 一期产能压力，满足未来持续增长的产品订单供应。后续公司将持续跟踪下游需求变化，动态调整产能规划，确保产能与市场需求精准匹配。</p> <p>问 6：公司在光刻胶领域布局全面，目前该业务的核心优势及未来放量前景如何？</p> <p>答：公司作为国内成功开发出晶圆光刻胶、封装光刻胶和显示光刻胶三大类光刻胶的企业，在该领域具备显著的综合优势和发展潜力。核心优势主要体现在三点：一是技术实力雄厚，组建了优秀的专业技术团队，历时多年攻关打破国际技术壁垒，相关产品各项关键参数优秀，部分指标达到领先水平；二是产品矩阵完善，覆盖半导体制造、封装及显示全场景需求，可匹配下游不同客户的多样化应用场景；三是量产能力成熟，建成了显示 PSPI 评价实验室、封装光刻胶评价实验室和晶圆光刻胶评价实验室，分别在武汉、潜江、仙桃提前做好产能储备，能够快速响应客户订单需求。未来，随着下游半导体、OLED 显示行业持续发展，光刻胶市场需求将稳步扩容，公司将加快推进各类光刻胶产品的客户验证及市场开拓，进一步提升市场渗透率，助力该业务成为公司又一核心业绩增长极，发展前景广阔。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 1 月 21 日